

CONTRATTI DI FINANZIAMENTO AGENZIA SPAZIALE ITALIANA (SECONDO TRIMESTRE 2019)

N. BANDO FINANZIAMENTO	OGGETTO	TEMATICA BANDO	Modalità individuazione	NORMA DI RIFERIMENTO	Ufficio responsabile	Dirigente funzionario	n. decreto	data	n.	data	CONTRATTO N.	CONTRAENTE/ BENEFICIARIO	CODICE FISCALE BENEFICIARIO	IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO
	"Diodi spintronici rad-hard ad elevata sensibilità (DIOSPIN)"	Bando "Nuove idee per la componentistica spaziale del futuro"	Articoli 25 e 26 del Regolamento UE 651/2014	Regolamento UE 651/2014	Unità Tecnologie e Ingegneria - UTI	Ing. Roberto Formaro	219	24/11/2016	791	20/12/2017	2019-1-U.0	Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione (DEI) del Politecnico di Bari	93051590722	218.630,50
	Wafer Level Micropackaging di RF MEMS switch per applicazioni spaziali (WLM RF MEMS).	Bando "Nuove idee per la componentistica spaziale del futuro"	Articoli 25 e 26 del Regolamento UE 651/2014	Regolamento UE 651/2014	Unità Tecnologie e Ingegneria - UTI	Ing. Roberto Formaro	219	24/11/2016	791	20/12/2017	2019-2-U.0	Istituto di Microelettronica e Microsistemi (IMM) del CNR	80054330586	127.575,84